

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle
Bureau international



(10) Numéro de publication internationale
WO 2023/131654 A1

(43) Date de la publication internationale
13 juillet 2023 (13.07.2023)

WIPO | PCT

(51) Classification internationale des brevets :

H10N 30/01 (2023.01) *H10N 30/073* (2023.01)
H10N 30/071 (2023.01) *H10N 30/074* (2023.01)
H10N 30/072 (2023.01) *H10N 30/853* (2023.01)

Parc technologique des Fontaines, Chemin des Franques, 38190 Bernin (FR). **MOUREY, Odile** ; Parc Technologique des Fontaines, Chemin Des Franques, 38190 Bernin (FR).

(21) Numéro de la demande internationale :

PCT/EP2023/050191

(74) Mandataire : **GRÜNECKER PATENT- UND RECHTSANWÄLTE** ; Leopoldstr. 4, 80802 Munich (DE).

(22) Date de dépôt international :

05 janvier 2023 (05.01.2023)

(25) Langue de dépôt :

français

(26) Langue de publication :

français

(30) Données relatives à la priorité :

FR2200119 07 janvier 2022 (07.01.2022) FR

(71) Déposant : **SOITEC** [FR/FR] ; Parc Technologique des Fontaines, Chemin Des Franques, 38190 Bernin (FR).

(72) Inventeurs : **BERTRAND, Isabelle** ; Parc technologique des Fontaines, Chemin des Franques, 38190 Bernin (FR). **BELHACHEMI, Djamel** ; Parc technologique des Fontaines, Chemin des Franques, 38190 Bernin (FR). **LANDRU, Didier** ; Parc technologique des Fontaines, Chemin des Franques, 38190 Bernin (FR). **GIRAUD, Dorothée** ;

(81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible) : ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ,

(54) Title: METHOD FOR TREATING SUBSTRATES

(54) Titre : PROCÉDÉ DE TRAITEMENT DE SUBSTRATS

[Fig. 1]

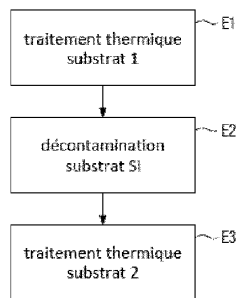


FIG. 1

E1 thermal treatment substrate 1
E2 decontamination Si substrate
E3 thermal treatment substrate 2

(57) Abstract: The invention relates to a method for treating substrates comprising: a step of treating a first substrate comprising at least one step carried out in an apparatus carrying out a thermal treatment, the first substrate being a substrate made of a semiconductor material or of a piezoelectric material; a step of decontaminating the apparatus carrying out a thermal treatment by a thermal treatment of a decontamination substrate, in particular a silicon substrate; and then a step of treating a second substrate comprising at least one step carried out in the apparatus carrying out a thermal treatment, the first substrate being a substrate made of a semiconductor material or of a piezoelectric material.

(57) Abrégé : L'invention concerne un procédé de traitement de substrats comprenant une étape de traitement d'un premier substrat comprenant au moins une étape réalisée dans un équipement réalisant un traitement thermique, le premier substrat étant un substrat d'un matériau semi-conducteur ou d'un matériau piézoélectrique, une étape de décontamination de l'équipement réalisant un traitement thermique par un traitement thermique d'un substrat de décontamination, en particulier un substrat en silicium, et ensuite une étape de traitement d'un deuxième substrat comprenant au moins une étape réalisée dans l'équipement réalisant un traitement thermique, le premier substrat étant un substrat d'un matériau semi-conducteur ou d'un matériau piézoélectrique.

[Suite sur la page suivante]

WO 2023/131654 A1

TM), européen (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée:

— avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3))